

索引

(日文-中文-English)

不良名	中文	English	コード	頁
A ～ Z				
AWF 合せズレ	AWF 对位の偏移	Phototool misalignment	2-1-1-2	101
AWF 下異物短絡	AWF 下面杂物的短路	Short by a foreign object under a phototool	1-8-3-1	82
AWF 下気泡短絡	AWF 下面存在气泡的短路	Short by bubble under phototool	1-8-3-2	83
AWF 傷短絡	AWF 划伤的短路	Short by scratch on phototool	1-8-3-5	84
AWF 傷突起	AWF 划伤的凸出	Projected conductor by a defective phototool	1-5-1-1	55
AWF 欠陥(細り)	AWF 缺陷(细)	Caused by defective phototool(Conductor width reduction)	1-4-3-	55
AWF 欠陥細り	AWF 缺陷的线细	Reduced conductor width by a defective phototool	1-4-3-1	55
AWF 密着不良短絡	AWF 压合不紧的短路	Short by poor phototool contact	1-8-3-4	84
AWF 汚れ欠け	AWF 玷污的缺口	Chipping by stained AWF Nick by stained phototool	1-2-2-6	44
AWF 汚れピンホール	AWF 玷污的针孔	Pinhole by stained phototool	1-3-2-2	51
CF 接着剤短絡	CF 粘性物の短路	Short by carrier film adhesive	1-8-1-3	79
CF 接着剤残り残銅	CF 粘性物の残余銅	Residual copper by carrier-film adhesive residue	1-6-1-4	72
CF 接着剤残り突起	CF 粘着剂屑的凸出	Projected conductor by debris of carrier film adhesive	1-5-1-13	62
DFR スカム短絡	DFR 余膜の短路	Short by dry film scum	1-8-2-1	81
DFR 密着不足細り	DFR 压合不紧的线细	Reduced conductor width by poor dry film adhesion	1-4-2-1	54
DFR 密着不良欠け	DFR 压合不紧的缺口	Nick by poor dry film adhesion	1-2-2-2	42
DFR 密着不良断線	DFR 压合不紧的开路	Open by poor dry film adhesion	1-1-5-4	28
DFR 密着不足(細り)	DFR 压合不紧(细)	Caused by poor dry film adhesion(Conductor width reduction)	1-4-2-	54
ET 異常(太り)	ET 异常(线粗)	Caused by irregular etching(Expanded copper)	1-7-2-	76
ET 液劣化太り	ET 液变质的线粗	Expanded conductor by deteriorated etchant	1-7-2-2	77
ET 過速太り	ET 太快的线粗	Expanded conductor by excessive etching-conveyor speed	1-7-2-1	76
ET 過多(細り)	ET 过度(细)	Caused by over etch(Conductor width reduction)	1-4-1-	53
ET 残り突起	ET 残留的凸出	Caused by incomplete etching	1-5-2-	64
ET ノズル詰り残銅	ET 喷嘴堵塞的残余銅	Residual copper by clogged etching nozzle	1-6-2-1	74
ET ノズル詰り短絡	ET 喷嘴堵塞的短路	Short by clogged etching nozzle	1-8-4-9	91
ET ノズル詰り突起	ET 喷嘴堵塞的凸出	Projected conductor by etching nozzle clogging	1-5-2-2	65
FPCSR 等傷	FPC 的 SR 等划伤	A scratch on solder resist of FPC	2-1-2-11	114
FPC 穴部 DFR 残り	FPC 孔残留 DFR	Dry film residue in an FPC hole	2-3-2-10	150
FPC 折れ	FPC 的折断	Sharp bend of FPC	7-4-27-	257
FPC カバーレイ下気泡残り	FPC 覆盖层存在气泡	Bubble under FPC coverlay	2-3-2-11	150

不良名	中文	English	コード	頁
FPC 屈曲疲労断線	FPC 弯曲疲劳的开路	Open by flexural fatigue of FPC	1-1-5-5	28
FPC 皺	FPC 起皱	Wrinkled FPC	7-4-31-	259
FPC 端子部折れ皺	FPC 插脚的折断起皱	Creased FPC edge contact	7-4-26-	256
FPC 非スル穴抜きバリ	FPC 非通孔的披锋	Burr on FPC non-plated through hole by punching	6-3-2-9	226
FPC 表面異物付着	FPC 表面附着杂物	Foreign objects on FPC surface	2-1-2-24	120
FPC 表面汚れ	FPC 表面的玷污	Dirty FPC surface	2-1-2-25	121
FPC ベース面打痕	FPC 基底有压痕	Dent on FPC base material surface	7-4-29-	258
FPC 補強板下気泡残り	FPC 增强板下吸附气泡	Bubble under FPC stiffener	7-4-30-	258
FPC 補強板ズレ	FPC 增强板的偏移	FPC stiffener displacement	7-4-24-	255
FPC 補強板剥がれ	FPC 增强板的剥落	FPC stiffener separation	7-4-25-	256
PSR 未露光部不付き	PSR 未曝光部位的剥落	Photo solder resist missing caused by a foreign object	2-2-2-3	138
SR 当て傷	SR 的碰伤	Nick on solder resist	2-1-2-13	115
SR 異物挟まり傷剥がれ	SR 夹杂杂物的剥离伤痕	Spotty peeling of solder resist	2-1-2-39	128
SR インク切れかすれ	SR 油墨中断的漏印	Solder resist blur by ink run-out	2-1-2-1	108
SR インク屑付着	附着 SR 油墨屑	Cured ink debris on solder resist	2-2-1-8	133
SR インク溜まり	SR 油墨的积聚（聚油）	Solder resist ink drop	2-1-1-7	103
SR インク違い	误用 SR 油墨	Wrong solder resist ink	2-1-1-6	103
SR エッジ厚不足	SR 边缘厚度不足	Insufficient solder resist thickness at a conductor edge	2-3-2-2	146
SR 回路形状転写	SR 线路形状的转移	Conductor pattern transferred on solder resist	2-1-2-37	127
SR かすれ	SR 的漏印	Solder resist blur	2-1-1-4	102
SR 被り	SR 爬上导线	Solder resist left on conductor to be exposed	2-3-2-1	145
SR 過焼き	SR 的烘干过度	Overcured solder resist	2-1-2-36	126
SR 基板加工屑巻込み	SR 卷入树脂屑	Board debris in solder resist	2-2-1-11	135
SR 気泡抱込	SR 吸附气泡	Air entrapped in solder resist	2-1-1-8	104
SR 狭隙部割れ	SR 在狭隙部位的裂痕	Solder resist cracking in a narrow area	2-3-2-12	151
SR 金属異物巻込み	SR 卷入金属屑	A metallic foreign object in solder resist	2-2-1-7	133
SR 欠陥	SR 的缺陷	Solder resist defects	2-	100
SR 下地 DFR 屑残り	SR 基底残留 DFR 屑	Dry film debris on base material under solder resist	2-2-1-12	135
SR 基底地インク汚れ	SR 基底的油墨玷污	Ink-stained conductor under solder resist	2-1-2-40	128
SR 下地基板樹脂部傷	SR 基底的树脂损伤	Scratch on base laminate under solder resist	2-1-2-33	125
SR 下地研磨傷	SR 基底的磨伤	Abrasion mark on basis metal under solder resist	2-3-1-3	142
SR 下地指紋汚れ	SR 基底的指纹玷污	Fingerprint on base material under solder resist	2-1-2-28	122
SR 下地静電傷	SR 基底的静电损伤	Cut on the basis conductor under solder resist by electrostatic discharge	2-3-2-8	149
SR 下地導体傷	SR 基底的导线损伤	Scratch on the conductor under solder resist	2-1-2-32	124
SR 下地糊状異物付着	SR 的基底附着粘性杂物	Pasty foreign material under solder resist	2-1-2-27	122
SR 下地×印残り	SR 基底有 X 标记	"X" mark on the base material under solder resist	2-1-2-30	123
SR 下地マジックマーク残り	SR 基底残留墨水标记	Marker pen mark on base material under solder resist	2-1-2-31	124
SR 下地汚れ	SR 的基底玷污	Dirty base material under solder resist	2-1-2-26	121
SR 下テープ残り	SR 基底的胶带	Tape left under solder resist	2-1-2-29	123
SR 指紋汚れ転写	SR 指纹玷污的转移	Fingerprint on solder resist surface	2-1-2-19	118
SR 充填不足白化	SR 的填充不足晕圈	Whitened solder resist by insufficient ink filling	2-3-2-13	152

不良名	中文	English	コード	頁
SR 衝突剥がれ	SR 碰撞的剥落	Peeled off solder resist by impact	2-1-2-8	112
SR 人毛付着	SR 附着毛发	Attached hair on solder resist	2-2-1-1	129
SR 擦り付け付着	擦上并附着 SR	Soils rubbed on solder resist surface	2-1-2-17	117
SR 擦れ跡残り	SR 的摩擦痕迹	Abrasion mark on solder resist	2-1-2-3	109
SR 静電気むら	SR 因静电而不均匀	Uneven solder resist surface caused by electro-static discharge	2-3-2-7	148
SR 接触跡残り	SR 的接触痕迹	Contact mark on solder resist	2-1-2-2	109
SR 接触傷	SR 的划伤	Scratch on solder resist	2-1-2-10	113
SR 纖維付着	SR 附着纤维	Attached fibre on solder resist	2-2-1-2	129
SR 装置傷	SR 接触装置的伤害	Scratch on solder resist of the equipment	2-3-1-6	144
SR 装置接触跡	SR 接触装置痕迹	Equipment contact mark on solder resist	2-3-1-2	142
SR 打痕	SR 的压痕	Dent on solder resist	2-1-2-4	110
SR タッキング剥がれ	SR 钉头状的剥落	Peeled solder resist by tacking	2-3-1-1	141
SR 滴下引ずり付着	滴下 SR 并拖拉	Ink drop and run on solder resist surface	2-1-2-18	117
SR 滴下付着	SR 的滴下并附着	Drop of solder resist ink	2-1-2-16	116
SR 天井裏埃付着	SR 附着天棚里面的灰尘	Ceiling dust on solder resist	2-2-1-4	131
SR 導体間剥がれ	SR 在导线之间剥落	Solder resist missing between conductors	2-3-2-4	147
SR にじみ	SR 的渗出	Solder resist (spread) ooze	2-1-1-5	102
SR 剥離塗装片巻込み	SR 卷入油漆屑	Peeled paint debris in solder resist	2-2-1-10	134
SR 挟まれ傷	SR 的夹伤	Pinch mark on solder resist	2-3-1-4	143
SR はじき	SR 迸开变薄	Cratered solder resist	2-2-1-14	136
SR はんだ付着	SR 附着焊料	Attached solder on solder resist area	2-2-1-13	136
SR 引拔擦り傷	SR 的拉伤	Scratch on solder resist by board pulling	2-1-2-14	115
SR 非金属異物巻込み	SR 卷入非金属杂物	A non-metal foreign object trapped in solder resist	2-2-1-5	132
SR 微細虫死骸付着	SR 附着幼虫尸骸	Small insect body on solder resist	2-2-1-6	132
SR 表面指紋残り	SR 表面印有指纹	Fingerprint on the solder resist surface	2-1-2-35	126
SR 表面粘着物付着	SR 表面附着粘性物	Adhesive material on solder resist surface	2-2-1-15	137
SR 表面糊状異物付着	SR 表面附着粘性杂物	Pasty foreign object on solder resist surface	2-1-2-21	119
SR ピンホール	SR 的针孔	Solder resist pinhole	2-2-2-4	139
SR 膨れ	SR 分层	Blistered solder resist	2-2-2-6	140
SR 部分的むら	SR 的局部颜色不均匀	Partially uneven solder resist	2-3-1-7	144
SR 面テープ残り	SR 表面附着胶带屑	Tape left on solder resist surface	2-1-2-22	119
SR 面マジックインク汚れ	SR 表面的墨水玷污	Solder resist surface contaminated with marker pen ink	2-1-2-23	120
SR レベラ傷	SR 在热风整平时的划伤	Scratch on solder resist by HAL	2-3-1-5	143
SR 割れ	SR 的裂缝	Solder resist crack	2-1-1-16	108
V カット加工欠陥	V 形槽的加工缺陷	V-grooving defect	6-2-	214
V カットによる銅見え	V 形槽露铜	Exposed copper by V-grooving	6-2-11-	219
V カット溝位置ズレ	V 形槽的位置偏移	Displaced V groove position	6-2-2-	214
V カット溝外方持部脱落	V 形槽的单侧脱落	Fall-off of cantilever outside of V groove	6-2-12-	220
V カット溝角度不良	V 形槽的角度不良	Improper V groove angle	6-2-4-	215
V カット溝加工漏れ	漏开 V 形槽	V-grooving failure	6-2-5-	216
V カット溝過多	V 形槽太多	Excessive number of V grooves	6-2-6-	216

不良名	中 文	English	コード	頁
V カット溝かぶり断線	V 形槽错位的开路	Open by a dislocated V groove	1-1-5-2	26
V カット溝のど厚不良	V 形槽の厚度不足	Improper residual laminate thickness in V-grooving (Improper throat thickness)	6-2-3-	215
V カット溝バリ	V 形槽的披锋	Burr in V groove	6-2-10-	219
V カット溝割り困難	V 形槽的掰开困难	Difficulty in breaking out at a V groove	6-2-8-	217
V カット溝割れ	V 形槽的断裂	Cracked V-groove	6-2-7-	217

あ

圧着突起	压着铜屑の凸出	Outward conductor projection by adhered debris	1-5-1-8	60
圧着表面突起	压着小铜屑の凸出	Conductor projection by adhered debris	1-5-1-9	60
穴内加工異常	孔加工异常	Caused by improper hole quality	5-1-1-	193
穴荒れによる気泡残りスル断	孔粗糙吸附气泡的通孔开路	PTH open by trapped bubble in rugged hole	1-1-4-7	21
穴位置ズレ	孔位的偏移	Displaced hole position	6-4-2-	227
穴埋インク垂込み	塞孔油墨的垂入	Drop-in of hole plugging paste	7-4-19-	253
穴埋凹み起因 DFR 不密着欠け	填孔凹陷, DFR 压合不紧的缺口。	Chipping by poor DFR adhesion on plugged hole Conductor nick on a plugged hole by poor dry	1-2-2-14	49
穴加工位置違い	孔位的错误	Wrong hole position	6-3-2-5	224
穴かぶり断線	孔错位的开路	Open by improper hole on conductor	1-1-5-1	26
穴傷	孔伤	Board damage making a hole	7-4-22-	254
穴形状不良	孔的形状欠佳	Defective hole shape	6-3-2-8	225
穴径違い	孔径的错误	Wrong hole size	6-3-2-2	222
穴数違い	孔数量的错误	Wrong number of holes	6-3-2-4	223
穴内はんだ詰り	孔内堵塞焊料	Solder plugged hole	4-3-2-2	188
穴バリ	孔的披锋	Hole with burrs	6-4-6-	229
穴曲がり	孔的弯曲	Leaned hole	6-4-3-	227
アルミ基板 SR 打痕	铝基板的 SR 压痕	Dent on solder resist on aluminum-base printed board	2-1-2-6	111
合せズレランド欠け	错位的焊环缺口	Hole break-out by misalignment	1-2-2-7	45
アンダコート印刷ズレ	底涂层的印刷偏移	Displacement in undercoat printing	7-4-16-	251
異形裾残り欠け	锯齿状的缺口	Tailed nick by a foreign object	1-2-1-4	36
異形裾残り断線	异型锯齿状的开路	An open tailing caused by a foreign object	1-1-1-8	6
異常形状回路	线路的形状异常	Abnormal conductor pattern	1-9-3-	99
板目不良	板纹不对	Wrong board direction relative to reinforcement fabric orientation	7-4-6-	246
糸状断線	直线形状的开路	Threadlike open	1-1-1-3	2
異物起因 (SR 欠陥)	杂物起因 (SR の缺陷)	Caused by foreign objects(solder resist defects)	2-2-	129
異物起因 (金めっき欠陥)	杂物起因 (镀金层缺陷)	Caused by foreign objects(gold plating defects)	4-2-1-	173
異物起因 (欠け)	杂物起因 (缺口)	Caused by foreign objects(nicks)	1-2-1-	34
異物起因 (残銅)	杂物起因 (残余铜)	Caused by foreign objects(residual copper)	1-6-1-	70
異物起因 (シンボルマーク欠陥)	杂物的起因 (字符的缺陷)	Caused by foreign objects(symbol mark defects)	3-2-1-	162
異物起因端子欠け	插脚的杂物缺口	Nick of edge edge contact by a foreign object	1-2-1-10	40
異物起因 (断線)	杂物起因 (开路)	Caused by foreign object(electrical open)	1-1-1-	1
異物起因 (銅めっき欠陥)	杂物的起因 (镀铜层的缺陷)	Caused by foreign objects(Copper plating defects)	4-1-1-	167
異物起因 (突起)	杂物起因 (凸出)	Caused by foreign objects(conductor protrusion)	1-5-1-	55
異物起因はんだ濡れ不良	杂物起因的不润湿	Poor solder wetting by foreign material	4-3-2-7	191

不良名	中文	English	コード	頁
異物起因（太り）	杂物起因（线粗）	Caused by foreign objects(expanded copper)	1-7-1-	75
異物残存（SR 欠陥）	杂物残留（SR 的缺陷）	Foreign object remained (solder resist defects)	2-2-1-	129
異物詰りスル断	堵塞杂物的通孔开路	PTH open by plugging of a foreign object	1-1-4-8	22
異物剥離部 SR 不付き	杂物剥落部位的 SR 不粘結	Solder resist missing at a peeled foreign object	2-2-2-2	138
異物非残存（SR 欠陥）	非杂物残留（SR 的缺陷）	Marks of foreign object(solder resist defects)	2-2-2-	137
異物付着めっき不良断線	镀层附着杂物的开路	Open by defective plating by an attached foreign object	1-1-1-13	9
異物巻込はんだ	卷入杂物的焊料	Entrapped foreign object in solder	4-3-2-1	188
異物起因（ピンホール）	杂物起因（针孔）	Caused by foreign objects(pinhole)	1-3-1-	50
印刷作業不適（シンボルマーク欠陥）	印刷作业不熟练（字符的缺陷）	Improper printing work(Symbol mark defects)	3-1-	153
印刷版乳剂剥れ SR 付着	网版的乳剂剥落并在 SR 附着	Superfluous solder resist by screen with partially peeled emulsion	2-1-2-20	118
ウィッキング	灯芯	Wicking	5-1-2-9	201
ウィスカ	晶須	Whisker	1-5-1-12	62
ウィッキング短絡	灯芯的短路	Short by wicking	1-8-4-4	87
エッチバック形状スルーホール	凹蚀的通孔	Etchback-shaped PTH sidewall	5-1-2-4	198
円形打痕欠け	圆形压痕的缺口	Round nick by dent	1-2-1-5	37
凹状断線	凹状的开路	Concave open	1-1-1-6	4

か

カーボン印刷異物巻込み	碳油卷入杂物	Foreign object in carbon paste print	7-4-1-	243
カーボン印刷欠け	碳油印刷的缺口	Nick of carbon printed pattern	1-2-2-13	48
カーボン回路短絡	碳膏线路的短路	Short between carbon paste conductors	1-8-4-17	96
界面マイグレーション	界面的迁移	Migration at interface	1-8-4-6	89
回路ギザ	锯齿的线路	Rough edged conductor	1-2-2-8	45
回路形状不適短絡	线路设计不合理的短路	Short by improper conductive pattern	1-8-4-19	97
回路形状不適突起	线路形状异常的凸出	Projected conductor by improper pattern configuration	1-5-2-1	64
回路欠陥	线路缺陷	Conductor defects	1-	1
回路欠陥部 SR 不付	SR 在线路缺陷部位不黏結	No solder resist on conductor defect	2-3-2-6	148
回路状断線	线路形状的开路	Conductor-pattern-like open	1-1-1-4	3
回路線ダメージ変形	线路损坏的变形	Deformed conductor by board damage	1-9-1-	98
回路線剥離	线路剥落	Torn off conductor	1-9-2-	98
欠け	缺口	Nicks	1-2-	34
欠け状疑似断線	疑似缺口的开路	Quasi open by nicking	1-1-6-1	29
加工長さ違い	加工长度的错误	Wrong machining length	6-3-2-3	223
加工不良	加工不良	Bad machining	6-3-2-	222
加工漏れ	漏加工	Machining process omitted	6-3-1-	220
カバーレイ傷	覆盖层的划伤	Scratch on coverlay	2-1-2-12	114
カバーレイ下異物巻込み	覆盖层的基底夹杂杂物	A foreign object under coverlay	2-2-1-3	130
カバーレイ下地銅箔変色	覆盖层基底的铜箔变色	Discoloured copper foil under coverlay	2-1-2-34	125
カバーレイ打痕	覆盖层的压痕	Dent on coverlay	2-1-2-5	110
カバーレイ貼りズレ	覆盖膜的压合偏移	Inaccurate coverlay placement	2-1-1-3	101
ガラスクロスマイグレーション (CAF)	在玻璃纤维的迁移	Migration along glass cloth surface (CAF = Conductive Anodic Filament)	1-8-4-7	89

不良名	中文	English	コード	頁
乾燥機ヤニ付着	附着松香	Dirty board by pitch from cure oven	7-4-13-	250
機械加工欠陥	机械加工的缺陷	Machining defects	6-	208
基材打痕欠け	基材压痕的缺口	Nick by dent on base material	1-2-1-9	39
基材ダメージ部食われ断線	基材损坏并被腐蚀的开路	Open by damaged base material	1-1-3-6	16
疑似断線	疑似开路	Quasi open	1-1-6-	29
擬似短絡	擬似短路	Quasi short	1-8-4-15	95
基準マーク欠け	基准标记的缺口	Nick of fiducial mark	1-2-2-9	46
傷断線	划伤的开路	Open along scratch	1-1-2-3	11
技能未熟 (SR 欠陥)	技能生疏 (SR 的缺陷)	Caused by unskilled work(Solder resist defects)	2-1-1-	100
技能未熟 (シンボルマーク欠陥)	技能生疏 (字符的缺陷)	Caused by unskilled work(Symbol mark defects)	3-1-1-	153
基板傷欠け	板伤的缺口	Nick by board surface damage	1-2-2-1	42
基板傷起因 (断線)	板件损伤的起因 (开路)	Caused by scratches(Electrical open)	1-1-3-	13
基板傷断線	板伤的开路	Open caused by scratch on board	1-1-3-1	13
基板積層ポイド	层压板有空洞	Void in laminate	7-1-2-	235
基板打痕欠け	板件压痕的缺口	Nick by base material dent	1-2-2-4	43
基板銅めっき面薬液食れ	镀铜面被药液腐蚀	Etched copper of base material	1-2-2-10	47
基板に発生する欠陥	电路板上发生的缺陷	Defects of base material	8-1-1-	260
基板ヘアクラック	板边的龟裂	Hair-cracked board	6-4-16-	233
気泡介在 SR 不付き	SR 存在气泡的剥落	Solder resist missing by bubble	2-2-2-5	140
気泡残リスル断	残留气泡的通孔开路	PTH open by trapped bubble	1-1-4-4	19
逆エッチバック形状スルーホール	反向凹蚀的通孔	Negative-etchback-shaped PTH side wall	5-1-2-5	199
銀充填過多	銀膏的充填过量	Excessive silver paste filling	5-2-5-	204
銀スルーホール欠陥	银通孔的缺陷	Silver-paste through-hole defects	5-2-	202
銀スルーホール欠落	银通孔的欠缺	Missing silver-paste through hole	5-2-9-	206
銀スルーホールポイド	银通孔的空洞	Void in silver-paste through hole	5-2-10-	207
銀スルオーバーコートズレ	银通孔的表面涂层的偏移	Displaced overcoat silver of through hole	5-2-3-	203
銀スル首部ペースト厚過剰	银通孔颈的银膏过剩	Excessive silver paste thickness at hole neck	5-2-2-	203
銀スル充填不足	银通孔的填充不足	Insufficient silver paste filling	5-2-1-	202
銀スル用オーバーコート欠け	银通孔的表面涂层有缺口	Chipped silver through hole overcoat	5-2-8-	206
金端子部打痕	镀金插脚的压痕	Dent on gold plated edge board contact	7-4-12-	249
銀にじみ	银膏的渗出	Blurred silver paste	5-2-6-	205
銀ペースト異物巻込み	银膏卷入杂物	Foreign object entrapped in silver paste	5-2-7-	205
銀ペースト飛び	银膏的飞溅	Splash of silver paste	5-2-4-	204
金めっき厚不良	镀金层的厚度不足	Improper gold deposit thickness	4-2-2-2	180
金めっき傷	镀金层的划伤	Scratch on gold deposit	4-2-1-7	176
金めっき欠陥	镀金层缺陷	Gold plating defects	4-2-	173
金めっき下地打痕	镀金层的基底有压痕	Dent on gold plating basis metal	4-2-3-1	181
金めっき析出異常	镀金层的沉积异常	Abnormal gold deposition	4-2-1-6	176
金めっき端子異物付着	镀金插脚上附着杂物	Foreign object on gold edge board contact	4-2-1-9	178
金めっき端子打痕	镀金插脚的压痕	Dent on gold plated edge board contact	4-2-1-10	179
金めっき端子ドリル穴残り	镀金插脚上有多余孔	Trace of drilled hole on gold edge board contact	4-2-4-1	184

不良名	中文	English	コード	頁
金めっき違い	镀金层的不相同	Wrong type of gold plating	4-2-2-3	180
金めっき剥がれ	镀金层的剥落	Peeled gold deposit	4-2-1-4	175
金めっき表面粒状突起	镀金表面的粒子凸出	Granular nodule on gold plated surface	1-5-3-8	69
金めっきピンホール	镀金层的针孔	Pinhole in gold deposit	4-2-1-5	175
金めっき膨れ	镀金层起泡	Blistered gold deposit	4-2-1-3	174
金めっき不付	金层不粘结	No gold deposit	4-2-1-1	173
金めっき降り	镀金层的下沉	Gold particle scattered on solder resist	4-2-2-1	179
金めっき変色	镀金层变色	Discoloured gold deposit	4-2-1-2	174
金めっき汚れ残り	镀金层的玷污	Stain residue on gold deposit	4-2-1-8	178
空隙マイグレーション	在空隙的迁移	Migration along void	1-8-4-8	90
クレージング	微裂缝	Crazing	8-1-1-4	262
研磨傷起因擬似断線	磨伤的疑似开路	Quasi open by abrasion scratch	1-1-6-7	33
研磨傷断線	磨伤的开路	Open by abrasion scratch	1-1-3-2	13
交叉Vカット溝外はずれ	交叉V形槽的外侧断离	A displaced corner in crossed V grooves	6-2-9-	218
コンデンサ漏液による導体銅溶解	电容器漏液引起导线铜的溶解	Dissolved copper conductor by leaked electrolyte of capacitor	7-4-21-	254

さ

作業不適 (SR 欠陥)	作業不熟练 (SR 的缺陷)	Improper work(Solder resist defects)	2-1-	100
座繰り加工欠陥	沉孔的缺陷	Defective counterbore	6-4-1-	226
座繰り部糊付着	沉孔的胶迹	Paste on counterbored area	7-4-11-	249
皿型厚み欠け	厚碟形的缺口	Dish shaped nick	1-2-1-7	38
皿型擬似断線	碟形的疑似开路	Dish shaped quasi open	1-1-6-3	30
残液食われスル断	残液腐蚀的通孔开路	PTH open by etching of conductor by residual chemical	1-1-4-2	17
サンドイッチ欠け	夹层的缺口	Nick by adhesive sandwiching	1-2-1-8	39
残銅	残余铜	Residual copper	1-6-	70
自挿痕	自动插入时的压痕	Dent by automatic insertion	10-1-9-	276
下地状態異常起因	基底的状态异常	Caused by defective basis metal	4-2-3-	181
下地銅欠陥金めっきピット	基底铜层有缺陷引起镀金层的凹坑	Pit on gold deposit caused by base copper defect	4-2-3-4	183
下地銅変質起因金めっきピット	基底铜层变质引起的镀金层凹坑	Pit on gold deposit caused by degraded base copper	4-2-3-3	182
下地 Ni 欠陥金めっきピット	基底镍层有缺陷引起镀金层的凹坑	Pit on gold deposit caused by base nickel defect	4-2-3-5	183
下地 Ni 腐食金めっきピット	基底镍层被腐蚀引起镀金层的凹坑	Gold plating pit on corroded Ni basis	4-2-3-6	184
実装に伴う欠陥	封装时的缺陷	Defects related to component mounting	10-1-	270
ジャンパ端子アングコート滲み	跨线插脚的底涂层渗油	Bleeding of undercoat at jumper terminal	7-4-15-	251
樹脂中マイグレーション	在树脂中的迁移	Migration within resin	1-8-4-5	88
衝撃クラックスル断	冲击裂缝的通孔开路	PTH open by mechanical shock	1-1-4-3	18
衝撃削れ断線	冲击切削的开路	Open by impact scrape	1-1-2-4	12
衝撃割れ断線	冲击裂缝的开路	Open by impact cracking	1-1-2-2	11
人体系異物付着	附着人体的污垢	Human-originated foreign object	2-2-1-9	134
シルクインク付着	丝印油墨的附着	Soil by symbol mark ink	3-2-1-2	162
シンボルマーク位置ズレ	字符的偏移	Displaced symbol mark	3-1-2-1	156
シンボルマーク一部不印刷	字符的漏印	Partly unprinted symbol mark	3-1-2-8	160

不良名	中文	English	コード	頁
シンボルマーク異物着脱欠け	字符上杂物脱落的缺口	Chipped symbol mark by a detached foreign object	3-2-1-3	163
シンボルマーク色違い	字符的颜色差错	Wrong coloured symbol mark	3-1-2-5	158
シンボルマーク色むら	字符的颜色不均匀	Unevenly coloured symbol mark	3-1-1-4	155
シンボルマークインク静電飛	静电使字符油墨飞溅	Splashed symbol mark ink by electrostatic charge	3-2-2-2	165
シンボルマークインク垂込	字符油墨的垂入	Symbol mark ink filled hole	3-2-2-1	164
シンボルマークインク付着	附着字符油墨	Soil of symbol mark ink	3-1-2-7	159
シンボルマーク印刷部銅見え	在字符部位露铜	Exposed copper in peeled symbol mark print	3-2-1-5	164
シンボルマークかすれ	字符不饱满	Blurred symbol mark	3-1-1-1	153
シンボルマーク過焼	字符的烘干过度	Overcured symbol mark	3-1-2-9	161
シンボルマーク逆刷り	字符的反向印刷	Reversely printed symbol mark	3-1-2-4	158
シンボルマーク崩れ	字符的崩溃	Deformed symbol mark	3-1-2-3	157
シンボルマーク欠陥	字符的缺陷	Symbol mark defects	3-	153
シンボルマークこすれ	字符被摩擦	Rubbed symbol mark	3-1-2-2	157
シンボルマーク端子部被り	字符爬上插脚	Symbol mark over edge board contact	3-1-1-6	156
シンボルマーク転写	字符的转移	Transferred symbol mark	3-1-2-6	159
シンボルマークにじみ	字符渗油	Spread symbol mark	3-1-1-2	153
シンボルマーク剥がれ	字符的剥落	Peeled symbol mark	3-1-1-3	154
シンボルマーク剥がれ	字符的剥落	Peeled symbol mark	3-2-1-1	162
シンボルマークピンホール	字符有针孔	Pinhole in symbol mark	3-1-1-5	155
シンボルマーク膨れ	字符的起泡	Symbol mark blister	3-2-2-3	166
シンボルマーク目詰欠け	字符网版的网目堵塞的缺口	Chipped symbol mark by screen clogging	3-1-2-10	161
シンボルマーク面汚れ	字符面的玷污	Dirty symbol mark surface	3-2-1-4	163
信頼性不足	可靠性差	Insufficient board reliability	8-	260
スカム突起	余膜的凸出	Projected conductor by scam	1-5-1-3	56
スカム・ヘドロ残銅	余膜、污泥的残余铜	Scum or sludge-like residual copper	1-6-1-1	70
捨て基板部残銅	板边的残余铜	Residual copper on board border area	1-6-2-2	75
ストリップコート穴内残り	可剥离膜残留在孔内	Strip coat residue in hole	7-4-3-	244
スリット加工漏れ	漏开槽口	Omitted slitting process	6-3-1-1	220
スリット・長穴・ミシン目加工欠陥	槽口、长孔、邮票孔的缺陷	Defects in machining slits, slots and perforations	6-3-	220
スリバ	镀屑	Sliver	1-5-3-3	66
スルーホール・ル穴バリ突起	通孔披锋的凸出	Projected conductor by through-hole burr	1-5-3-7	69
スルーホール欠け	通孔的缺口	Missing Hole wall conductor of PTH	5-1-2-7	200
スルーホール擬似断線	通孔的疑似开路	Quasi PTH open	1-1-6-6	32
スルホール欠陥	通孔的缺陷	PTH defects	5-	193
スルーホールコーナダメージ	通孔拐角的损坏	Damaged PTH corner	5-1-2-10	202
スルーホールコーナクラック	通孔的拐角有裂缝	Corner crack of PTH	8-1-2-2	263
スルーホール内異物詰まり	通孔内堵塞杂物	PTH hole clogging with foreign object	5-1-2-1	196
スルーホール内ガラス基材凸出	通孔内的玻璃纤维凸出	Glass fiber protrusion in PTH	5-1-1-3	194
スルーホール内スミア残り	通孔内残留钻污	Resin smear in PTH	5-1-1-5	196
スルーホール内壁荒れ	通孔内壁粗糙	Rough hole wall	5-1-1-4	195
スルーホール内壁ノジュール	通孔内壁的镀瘤	Nodule on PTH wall	5-1-2-3	198

不良名	中文	English	コード	頁
スルーホールバリ残り	通孔の披鋒	Burr in PTH	5-1-1-2	193
スルーホールバレルクラック	通孔の孔壁裂縫	Barrel crack of PTH wall	8-1-2-4	264
スルーホールはんだ上がり欠陥	通孔の可焊性差	Defective soldered PTH	9-1-	267
スルーホールフォイルクラック	通孔箔裂縫	Foil crack in PTH	8-1-2-3	264
スルーホールボイド	通孔の空洞	Plating void in PTH	5-1-2-2	197
スルーホール周りに発生する欠陥	通孔周囲の缺陷	Defects around PTH	8-1-2-	263
スルーホールめっき剥離	通孔镀层剥离	Separation of through-hole plating	10-1-6-	274
スルーホールランドリフト浮き	焊环的翹起	Lifted land of PTH	8-1-2-1	263
スルーホールランド欠け	焊环的缺口	Hole fragment	5-1-2-6	200
スルーホールレジソリセッション	通孔的树脂凹缩	Resin recession of PTH wall	8-1-2-5	265
スルーホール割り端子異物付着	半孔插脚附着杂物	Foreign object on divided PTH terminal	7-4-9-	248
スル下スミア残りスル断	钻污的通孔开路	PTH open by resin smear on via bottom land	1-1-4-9	23
スル内 SR 垂込み	SR 进入镀通孔	Solder resist dripped in plated through hole	2-1-1-12	106
スルホール断線	通孔的开路	PTH opens	1-1-4-	16
スル周リスミア残りスル断	孔壁周围残留钻污的通孔开路	PTH open by circumferential resin smear	1-1-4-10	23
スローイングパワ不適	分散能力差	Insufficient throwing power	4-1-2-5	172
静電気傷欠け	静电损伤的缺口	Nick by electrostatic discharge	1-2-2-3	43
静電傷疑似断線	静电损伤的疑似开路	Quasi open by electrostatic discharge	1-1-6-5	31
静電傷断線	静电伤的开路	Open by electrostatic discharge	1-1-3-4	14
静電気ピンホール	静电划伤的针孔	Pinhole by electrostatic discharge	1-3-2-1	51
静電コート塗布 P SR 現像残	静电喷涂的 SR 显影残渣	Photo solder resist residue after electrostatic coating	2-3-2-9	149
静電破壊転写	静电破坏的转移	Copper transfer by electrostatic destruction	7-4-20-	253
積層欠陥	层压的缺陷	Lamination defects	7-1-	235
積層板欠陥起因金めっきビット	层压板的缺陷引起镀金层的凹坑	Pit on gold deposit caused by laminate defect	4-2-3-2	182
積層樹脂流れ不良	层压时树脂流动不畅	Defective resin flow in lamination	7-1-4-	236
積層層間異物巻込み	层压板的层间卷入杂物	Foreign object between layers	7-1-5-	247
積層打痕	层压板有压痕	Dent on laminate	7-1-3-	236
積層銅箔面糊付着残銅	铜箔表面胶迹的残余铜	Residual copper under paste adhered on laminated copper foil	1-6-1-3	71
積層板欠陥	层压板的缺陷	Laminate defects	7-3-	240
積層板差による実装欠陥	封装的缺陷因层压板而差别	Solder joint defects due to different products used	10-1-10-	277
積層板樹脂中残銅	层压板树脂中的残余铜	Residual copper in laminate	1-6-1-5	72
積層板樹脂流れ欠陥	层压板的树脂流动缺陷	Defective resin flow in laminate	7-3-3-	242
積層板中異物巻込み	层压板中卷入杂物	Foreign object in laminate	7-3-1-	240
積層板中ボイド	层压板有空洞	Void in laminate	7-3-2-	241
積層板銅箔部皺	层压板的铜箔起皱	Wrinkled laminate copper foil	7-4-23-	255
積層板銅箔面異物起因(短絡)	层压板铜箔面的杂物起因(短路)	Caused by foreign objects on the copper surface of laminate(Electrical short)	1-8-1-	78
積層板剥離	层压板的分层	Delamination	7-3-4-	242
積層板表面糊付着突起	层压板面有胶迹的凸出	Projected conductor by adhesive on CCL surface	1-5-1-5	58
積層板巻込異物による残銅	层压板卷入残余铜	Residual copper by a foreign object in laminate	1-6-1-6	73
纖維状異物介在露光被り短絡	纤维杂物妨碍曝光的短路	Short by photographic fogging by an adhered fibrous object	1-8-3-6	85
全体の P SR 現像残り	整个板面的 PSR 显影不净	Entirely underdeveloped photo solder resist	2-1-1-9	104

不良名	中文	English	コード	頁
全体的細り	整体的线细	Reduced width throughout the conductor width	1-4-1-1	53
層間ズレ	层间偏移	Layer-to-layer misalignment	7-1-1-	235
層間導電異物短絡	导电性杂物的层间短路	Layer-to-layer short by a conductive foreign object	1-8-4-11	92
層間剥離スル断	爆板的通孔开路	PTH open by delamination	1-1-4-5	20
装置起因 (SR 欠陥)	装置起因 (SR 的缺陷)	Caused by improper equipment(solder resist defects)	2-3-1-	141
底張りはんだ	不润湿	Solder only on through-hole bottom	9-1-2-	267
組成異常はんだ濡れ不良	成分异常, 润湿性差	Poor solder wetting by improper solder composition	4-3-1-3	186
組成異常はんだブリッジ	成分异常的桥接	Solder bridge by improper solder composition	4-3-1-4	187
その他 (SR 欠陥)	其它 (SR 的缺陷)	Others(solder resist defects)	2-3-	141
その他 (SR その他欠陥)	其它 (SR 及其它的缺陷)	Other solder resist related defects	2-3-2-	145
その他 (回路欠陥)	其它 (线路缺陷)	Others(conductor defects)	1-9-	98
その他起因 (欠け)	其它起因 (缺口)	Resulted from other causes(nicks)	1-2-2-	42
その他 (機械加工欠陥)	其它 (机械加工的缺陷)	Others(machining defects)	6-4-	226
その他 (金めっき欠陥)	其它 (镀金层缺陷)	Others(gold plating defects)	4-2-4-	184
その他欠陥	其它的缺陷	Other defects	7-	235
その他 (残銅)	其它 (残余铜)	Others(residual copper)	1-6-2-	74
その他 (シンボルマーク欠陥)	其它 (字符的缺陷)	Others(symbol mark defects)	3-2-	162
その他	其它	Others	8-2-	265
その他 (銅スルーホール欠陥 (断線除く))	其它 (镀通孔的缺陷 (开路除外))	Others(copper PTH defects (excluding PTH open))	5-1-2-	196
その他 (その他欠陥)	其它 (其它的缺陷)	Others(other defects)	7-4-	243
その他 (シンボルマーク欠陥)	其它 (字符的缺陷)	Others(symbol mark defects)	3-2-2-	164
その他 (断線)	其它 (开路)	Others(Electrical open)	1-1-5-	26
その他 (短絡)	其它 (短路)	Others(Electrical short)	1-8-4-	86
その他 (突起)	其它 (凸出)	Others(conductor protrusion)	1-5-3-	65
その他 (はんだコーティング (HAL) 欠陥)	其它 (热风整平 (HAL) 的缺陷)	Others(solder coating (HAL) defects)	4-3-2-	188
その他 (ピンホール)	其它 (针孔)	Others(pinhole)	1-3-2-	51
その他 (太り)	其它 (线粗)	Others(Expanded copper)	1-7-3-	77

た

大径穴周り引掛け欠け	大径孔周围拉裂的缺口	Nick by tearing around large hole	1-2-2-11	47
耐電圧不足	介质强度差	Insufficient dielectric strength	8-2-1-	265
対面異形欠け	对面的异型缺口	Adjacent nicked conductors by foreign object	1-2-1-3	35
ダイレクト銅めっき異常	直接镀铜层的异常	Anomaly in direct copper plating	4-1-1-5	169
打痕欠け	压痕的缺口	Nick by dent	1-2-1-12	41
多層板内層粗化处理むら	内层的粗化处理不均匀	Uneven oxide treatment of innerlayer of multilayer board	7-4-4-	245
ダメージ欠け	损伤的缺口	Nick by board damage	1-2-2-5	44
ダメージ起因 (断線)	损坏起因 (开路)	Caused by damages to the board(Electrical open)	1-1-2-	10
ダメージ短絡	损伤的短路	Short by damaged conductor	1-8-4-3	87
ダメージ突起	压伤的凸出	Projected conductor by damaged board	1-5-3-1	65
端子間 SR 剥離片はんだ巻込み	焊料卷入插脚之间的 SR 碎片	Solder resist debris from between terminals entrapped in solder	4-3-2-10	192
端子部はんだ不付き	插脚的焊料不粘结	No solder on terminal	4-3-2-8	191

不良名	中文	English	コード	頁
端子部傷状 P SR 残り	插脚伤痕部的 PSR	Threadlike photo solder resist residue on edge board contact	2-1-2-38	127
端子部導体間隔小	插脚的导线间距小	Narrow spacing between edge board contacts	1-7-3-1	77
断線	开路	Electrical open	1-1-	1
断線同居異形欠け	与开路并存的异型缺口	Conductor nick and adjacent open by foreign object	1-2-1-2	35
単独異形欠け	异型的单独缺口	Isolated nick by foreign object	1-2-1-1	34
単独異形断線	单独的异型开路	Single open by a foreign object	1-1-1-1	1
短絡	短路	Electrical short	1-8-	78
チェック打痕	通断的压痕	Dent by test probe	7-4-2-	243
テープ糊短絡	胶带胶迹的短路	Short by tape adhesive	1-8-1-2	79
鉄基板 SR 傷	铁基板的 SR 划伤	Scraped solder resist on iron-base printed board	2-3-1-8	145
鉄基板 SR 接触傷	铁基板的 SR 划伤	Contact mark on iron-base printed board	2-1-2-9	113
鉄基板 SR 引抜擦り傷	铁基板的 SR 拉伤	Scratch on solder resist of iron-base board by board pulling	2-1-2-15	116
鉄基板 SR 傷表面微細傷	铁基板的 SR 表面的微裂痕	Fine scratch on solder resist on iron-base printed board	2-3-2-3	146
鉄基板 SR 付着物剥がれ	铁基板附着 SR 并剥落	Peeled off solder resist on iron-base printed board	2-1-2-7	112
鉄基板異物剥離部 SR 不付き	铁基板的杂物剥落部位的 SR 剥落	Solder resist missing on iron-base printed board due to a peeled foreign object	2-2-2-1	137
デラミネーション	分层	Delamination	8-1-1-1	260
電子部品実装はんだ周り欠陥	元件封装焊料周围的缺陷	Defective solder joints for component mounting	10-	270
テント破れスル断	掩膜破裂的通孔开路	Open PTH by broken tenting	1-1-4-1	16
銅スルーホール欠陥（断線除く）	镀通孔的缺陷（开路除外）	Copper PTH defects (excluding PTH open)	5-1-	193
銅スルーコーナ盛り	通孔拐角的鼓起	Raised copper deposit at PTH hole edge	5-1-2-8	201
導体間隔狭まり短絡	导线间距变窄的短路	Short by narrowed conductor spacing	1-8-4-12	93
導体貼付断線	导线转移的开路	Open by torn-off and sticked conductor	1-1-5-3	27
導体貼付突起	导线转移的凸出	Adhered and projected conductor	1-5-3-6	68
導体貼付ピンホール	导线转移的针孔	Pinhole by tear and transfer of conductor	1-3-2-3	52
導体部 DFR 残り	导线上有 DFR 屑	Dryfilm residue on conductor	7-4-5-	245
導体貼付欠け	导线转移的缺口	Nick by tear and transfer of conductor	1-2-2-12	48
銅端子部汚れ	铜插脚的玷污	Dirty bare-copper land	7-4-10-	248
導電性異物 SR 巻込短絡	SR 中卷入导电性杂物的短路	Short by a conductive foreign object within solder resist	1-8-4-2	86
導電性異物圧着短絡	压入导电性杂物的短路	Short by an adhered conductive foreign object	1-8-4-1	86
導電ペーストジャンパ異物付着	导电膏跨线附着杂物	Foreign object on conductive paste jumper	7-4-17-	252
導電ペーストジャンパ下充填不足	导电膏的基底填充不足	Insufficient underfill under conductive paste jumper	7-4-18-	252
導電ペーストジャンパ突起	导电膏跨线的凸出	Projected conductive paste jumper	1-5-3-5	68
導電ペースト露出	导电膏的露出	Exposed conductive paste	7-4-14-	250
銅片挟まり短絡	夹杂铜片的疑似短路	Quasi short by copper debris between conductor	1-8-4-16	95
銅めっき厚異常	镀铜层厚度的异常	Abnormal thickness of plated copper	4-1-2-1	170
銅めっき欠陥	镀铜层的缺陷	Copper plating defects	4-1-	167
銅めっきザラ	镀铜层粗糙	Rough copper electrodeposit	4-1-1-1	167
銅めっきノジュール	镀铜瘤	Copper plating nodule	4-1-1-6	170
銅めっき剥がれ	镀铜层的剥落	Poor peel strength of plated copper	4-1-2-2	171
銅めっき膨れ	镀铜层起泡	Plated copper blistering	4-1-1-3	168
銅めっきボイド	镀铜层的空洞	Copper plating void	4-1-2-4	172

不良名	中 文	English	コード	頁
銅めっき焼け	镀铜层烧焦	Burned copper deposit	4-1-2-3	171
突起	凸出	Conductor protrusion	1-5-	55
凸状裾残り断線	凸出锯齿状的开路	Convex tailing open	1-1-1-9	6
凸状断線	凸状の開路	Convex open	1-1-1-5	4
取扱傷断線	操作上损伤的开路	Open by handling scratch	1-1-3-3	14
取付け穴加工欠陥	安装孔的缺陷	Defective board fixing hole	6-4-14-	232
ドリル折れ穴未貫通	钻嘴折断且未钻透	Un-penetrated hole by broken drill bit	6-4-4-	228
ドリル振れ穴荒れ	钻嘴摆动的孔粗糙	Rugged hole by drill bit deflection	6-4-5-	228

な

内層欠け	内层的缺口	Nick of Inner layer conductor	1-2-1-13	41
内層材表面傷起因断線	内层表面划伤的开路	Open by damaged surface of internal base material	1-1-2-5	12
内層断線	内层的开路	Internal layer open	1-1-1-14	9
長穴エッジ打痕	长孔边缘有压痕	Dent on oblong hole edge	6-4-15-	233
長穴加工漏れ	漏开长孔	Omitted slotting process	6-3-1-2	221
長穴ダメージ変形	长孔损坏的变形	Deformed slot by damaging	6-4-11-	231
長穴ドリル加工不良	长孔的钻孔欠佳	Defective slot outlining	6-3-2-7	225
ニッケル金めっきヘアクラック	镀镍金层的龟裂	Hair crack in nickel/gold deposit	6-1-3-	209
ネイルヘッド	钉头	Nail head	5-1-1-1	193
熱被り太り	散热差的线粗	Expanded conductor by photographic thermal fogging	1-7-3-2	78
熱衝撃(1000c)前後の実装欠陥	热冲击(1000c)前后的封装焊接缺陷	Solder joint defects after thermal shock testing of about 1000 heat cycles	10-2-1-	279
熱衝撃試験前後の実装はんだ周り欠陥	热冲击试验前后的封装焊接周围的缺陷。	Solder joint defects before and after thermal shock test	10-2-	279
粘着性異物短絡	粘性杂物的短路	Short by adhesive foreign material	1-8-1-1	78
粘着物付着突起	粘性物的凸出	Projected conductor by adhesives	1-5-1-14	62
糊上銅めっき	胶迹上的镀铜层	Copper deposit on paste	4-1-1-2	168
糊サンド疑似断線	夹心胶的疑似开路	Quasi open by sandwiched adhesive	1-1-6-4	31
糊残り欠け	胶迹的缺口	Nick by residual adhesive	1-2-1-6	37
糊残り断線	胶迹的开路	Open caused by residual adhesive	1-1-1-10	7
糊付着短絡	胶迹的短路	Short by adhered adhesive	1-8-2-3	82

は

バイアホール SR 詰り	SR 堵塞导通孔	Via hole clogged with solder resist	2-1-1-13	106
パターン紛い短絡	疑似图形的短路	Conductor pattern-like short	1-8-4-13	93
針状断線	針状の開路	Needle-shaped open	1-1-1-7	5
ハローイング	晕圈	Haloing	6-1-10-	212
ハロゲンフリー材膨れ	无卤材料的分层	Blistered halogen-free base material	7-4-28-	257
版合せズレ	网版对位的偏移	Solder resist misalignment	2-1-1-1	100
はんだ上がり欠陥	可焊性的缺陷	Defects in soldering	9-	267
はんだ厚さむら	焊料的厚度不均匀	Uneven solder thickness	4-3-2-4	189
はんだ光沢不良	焊料无光泽	Poor solder luster	4-3-1-2	186
はんだコーティング(HAL)欠陥	热风整平(HAL)的缺陷	Solder coating (HAL) defects	4-3-	185

不良名	中文	English	コード	頁
はんだ差による実装欠陥	封装的缺陷因焊料而差别	Solder joint defects by use of solder of different makes	10-1-11-	277
はんだ充填不足	焊料填充不足	Insufficient solder filling in PTH	9-1-1-	267
はんだスルーホール内壁剥離	通孔内壁的焊料剥离	Separation of solder from PTH wall	10-1-7-	274
はんだ組成異常起因	焊料成分的异常	Caused by improper solder composition.	4-3-1-	185
はんだ付着	焊料的附着	Adhered solder	4-3-2-5	190
はんだブリッジ短絡	焊料桥接的短路	Short by solder bridge	1-8-4-10	92
はんだボール付着	焊珠的附着	Solder ball adhesion	4-3-2-6	190
はんだめっき穴径小	热风整平时孔径变小	Too small solder coated hole	4-3-2-9	192
はんだ盛り上がり過多	焊料隆起太多	Excessive solder mound	4-3-1-1	185
はんだ溶食擬似断線	焊料溶蚀的疑似开路	Quasi open by dissolution	1-1-6-2	29
ビアホールズレ擬似短絡	导通孔偏移的疑似短路	Quasi short by misaligned via hole	1-8-4-18	96
ビアホールズレ短絡	导通孔偏移的短路	Short by misaligned via hole	1-8-4-14	94
引け巣	收缩孔	Shrinkage cavity	10-1-3-	272
非スル穴 SR 垂込み	SR 进入非通孔	Solder resist dripped in non-plated through hole	2-1-1-11	105
ピット	麻点	Pit	1-3-1-2	50
表裏Vカット溝ズレ	上下V形槽不一致	V groove misalignment between front and back sides	6-2-1-	214
ピンホール	针孔	Pinhole	1-3-	50
ピンホール	针孔	Pinhole	1-3-1-1	50
複数異形断線	多条的异型开路	Multiple opens caused by a foreign object	1-1-1-2	2
複数傷断線	多处损伤的开路	Opens by multiple scratches	1-1-3-5	15
複数裾残り断線	多条锯齿状的开路	Multiple tailed open	1-1-1-12	8
複数引け巣	多点的收缩孔	Multiple shrinkage cavities	10-1-4-	273
膨れ・剥がれ・クラック・浮き等	分层、剥离、裂缝、鼓起	Blister, delamination, crack, lifting, etc.	8-1-	260
腐食突起	腐蚀的凸出	Projected conductor by etching of conductor	1-5-3-2	66
不注意 (SR 欠陥)	疏忽 (SR 的缺陷)	Caused by careless mistake	2-1-2-	108
不注意 (シンボルマーク欠陥)	疏忽 (字符的缺陷)	Caused by careless mistake(Symbol mark defects)	3-1-2-	156
ブッシュバック加工外れ	回压的脱位	Detached push back board	6-1-7-	211
ブッシュバック加工割れ	回压的裂缝	Board cracking by push back processs	6-1-4-	209
太り	线粗	Expanded copper	1-7-	75
部分的 P SR 現像残り	局部的 PSR 显影不净	Partially underdeveloped photo solder resist	2-1-1-10	105
部分的 SR 色むら	SR 的颜色局部不均匀	Local uneven colour of solder resistcolour	2-1-1-15	107
部分的 SR 詰り	局部堵塞 SR	Via hole clogged partially with solder resist	2-1-1-14	107
部分的細り	局部的线细	Locally reduced width of conductor	1-4-1-2	53
部分金めっき境界部 SR 剥れ	在部分镀金层的边界 PSR 剥落	Peeled solder resist along locally plated gold deposited boundary	2-3-2-5	147
ブラビア食われ断線	盲孔被腐蚀的开路	Open by etched down blind via	1-1-4-12	24
ブラビア形成漏れ断線	漏钻盲孔的开路	Open by absence of blind via hole	1-1-4-11	24
ブラビアめっき不析出断線	盲孔无镀层的开路	Open by non-plated blind via	1-1-4-13	25
ブリスト	爆板	Blister	8-1-1-2	261
プリフラックス (OSP) 異物付着	预助焊剂 (OSP) 附着杂物	Foreign object on preflux (OSP)	7-2-3-	239
プリフラックス欠陥	预助焊剂的缺陷	Preflux (OSP) application defects	7-2-	238
プリフラックス (OSP) 違い	预助焊剂 (OSP) 的差错	Wrong preflux (OSP)	7-2-4-	239

不良名	中文	English	コード	頁
ブリフラックス (OSP) 塗布むら	预助焊剂 (OSP) 涂布不均匀	Uneven preflux (OSP) application	7-2-1-	238
ブリフラックス (OSP) はじき	预助焊剂的凹陷	Repelled preflux (OSP)	7-2-5-	240
ブリフラックス (OSP) ベタ付き	预助焊剂 (OSP) 发粘	Tacky preflux (OSP)	7-2-2-	238
ブリブレグ残銅	B 片屑の残余銅	Residual copper under prepreg debris	1-6-1-2	70
ブリブレグ短絡	B 片屑の短路	Short by prepreg debris	1-8-1-4	80
ブリブレグ残り突起	B 片屑の凸出	Projected conductor by prepreg debris	1-5-1-7	59
プレス欠け	冲切的缺口	Chipped board by punching	6-1-8-	211
プレス加工欠陥	冲切的缺陷	Punching defect	6-1-	208
プレス滓上がり	冲切渣の堵塞	Hole plugged with punch debris	7-4-8-	247
プレス基材端部クラック	基材边缘有冲切裂缝	Cracked edge board by punching	6-1-11-	213
プレス基板割れ	板件的冲切裂缝	Cracked board by punching	6-1-2-	208
プレス打痕	冲切的压痕	Dent in punching	6-1-1-	208
プレス抜きズレ	冲切的偏移	Misalignment in punching	6-1-5-	210
プレスバリ	冲切的披锋	Burr by punching	6-1-9-	212
プレスミシン目割れ	邮票孔的爆裂	Cracking along perforation	6-1-6-	210
ブローホールはんだ	焊料有气孔	Solder joint with blow hole	9-1-4-	268
ヘドロ短絡	粘性污泥的短路	Short by sludge	1-8-2-2	81
ヘドロ突起	粘性污泥の凸出	Projected conductor by sludge	1-5-1-4	57
変形切断断線	变形而切断的开路	Deformed and broken open	1-1-2-1	10
細り	线细	Conductor width reduction	1-4-	53

ま

ミーズリング	白斑	Measling	8-1-1-3	261
ミシン目加工漏れ	漏开邮票孔	Omitted perforation process	6-3-1-3	221
ミシン目割れれ	邮票孔的裂开	Separated perforation	6-4-13-	232
溝形断線	槽型的开路	Groove-shaped open	1-1-1-11	8
溝幅違い	槽宽的错误	Wrong slit or slot width	6-3-2-1	222
ムダ金めっき付着	多余的镀金层	Gold deposit on unnecessary area	4-2-4-2	185
めっき欠陥	电镀的缺陷	Plating defects	4-	167
めっきザラ	碟形镀层	Rough plating	1-5-1-10	61
めっき条件管理不良起因 (金めっき欠陥)	电镀条件的管理不善 (镀金层缺陷)	Caused by improper plating condition(gold plating defects)	4-2-2-	179
めっき条件管理不良起因 (銅めっき欠陥)	电镀条件的管理不善 (镀铜层的缺陷)	Caused by improper plating condition(copper plating defects)	4-1-2-	170
めっきノジュール	镀瘤	Plating nodule	1-5-1-11	62
めっき面凹凸露光被り短絡	镀层面凹凸妨碍曝光的短路	Short by photographic fogging on rough plating	1-8-3-3	83
めっき面糊付着突起	镀层面有胶迹的凸出	Projected conductor by adhesive on plated surface	1-5-1-6	59
めっき面付着粘性異物起因 (短路)	镀层面附着粘性杂物的起因 (短路)	Caused by foreign adhesive objects on plated surface(Electrical short)	1-8-2-	81
面取り角度不良	倒角的角度欠佳	Wrong chamfer angle	6-4-7-	229
面取り幅不良	倒角的宽度不足	Wrong chamfer angle	6-4-8-	230
毛髪起因欠け	毛发的缺口	Nick by hair	1-2-1-11	40
藻巻込み銅めっき	镀铜层卷入藻类	Weed-like deposit of copper	4-1-1-4	169

不良名	中文	English	コード	頁
や ら わ				
余分穴	多余孔	Extra hole	6-3-2-6	224
ランド欠けスル断	焊环缺损的通孔开路	PTH open by land break	1-1-4-6	20
ランド舐めはんだ	焊环的吸锡	Solder only on through-hole land	9-1-3-	268
ランド剥離	焊环的剥离	Lifted land	10-1-2-	271
ランド変形	焊环变形	Deformed land	10-1-8-	275
リード線界面剥離	引脚的界面剥离	Separation of solder from component lead	10-1-5-	273
リフトオフ	剥离	Lift-off	10-1-1-	270
ルータ加工不良	铣切加工不良	Defective outlining	6-4-9-	230
ルータ加工バリ	铣切的披锋	Burr by routing	6-4-12-	231
ルータ加工ハローイング	铣切的晕圈	Haloing by routing	6-4-10-	231
レーザ穴突起	激光孔的凸出	Projected conductor from laser drilled hole	1-5-3-4	67
レベラ傷	热风整平时划伤	Scratch made in HAL	4-3-2-3	189
露光被り短絡	妨碍曝光的短路	Caused by photographic fogging	1-8-3-	82
露光被り突起	曝光阴影的凸出	Projected conductor by exposing light leakage	1-5-1-2	56
露光被り太り	曝光灰雾的线粗	Expanded conductor by photographic fogging	1-7-1-1	75
ワイヤボンディング不可	妨碍金属丝接合	Wire bonding failure	7-4-7-	246